

項次	專利名稱	國別	發明人	證書號	取證日	技術領域
1	METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE	美國	張翼,劉世謙,黃崇愷,吳佳勳,韓秉承,林岳欽,謝廷恩	US 12,426,344 B2	2025-09-23	晶圓代工, 應用於鐵電記憶體、FeFET、低功耗邏輯元件與新型半導體裝置
2	雙晶銅-鎳合金金屬層及其製備方法	韓國	陳智,李康平,張祐澤,陳昀萱	10-2846279	2025-08-11	晶圓製造(BEOL / 金屬互連), 主要用於高可靠性導線、功率半導體、先進封裝金屬層
3	具深度資訊之影像感測晶片	日本	李鎮宜,黃熙皓,黃子芸	特許 7657258	2025-03-27	IC 設計, 3D 深度影像感測 IC 設計領域(SPAD + TDC 架構), 應用於 ToF 感測、手機 3D 相機、LiDAR、AR/VR 與低光影像
4	MOCVD METHOD FOR GROWING INALGAN/GAN HETEROSTRUCTUR	美國	張翼,翁祐晨,鄭夏汐	US 12,347,678 B2	2025-07-01	晶圓製造(Foundry / 第三代半導體), 第三代半導體晶圓製造廠與 MOCVD 設備商
5	功率元件臨界電壓量測電路及其操作方法	台灣	盧斯坦,吳添立	I872683	2025-02-11	半導體設備, 功率半導體測試設備商
6	SOURCE-BODY SELF-ALIGNED METHOD OF A VERTICAL DOUBLE DIFFUSED METAL OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR	美國	崔秉鉞,王睿誠	US 12,256,559 B2	2025-03-18	晶圓製造(Foundry / Power Device), 可用於電源管理、車用電子與工控等功率元件應用領域
7	VIDEO DISPLAY SYSTEMS, PORTABLE VIDEO DISPLAY APPARATUSES AND VIDEO ENHANCEMENT METHODS	美國	李鎮宜,李有權	US 12,211,174 B2	2025-01-28	IC 設計, 影像處理晶片(ISP/VPU)與顯示影像增強 IC 的設計領域
8	MFMFET, MFMFET ARRAY, AND THE OPERATING METHOD THEREOF	美國	侯拓宏,吳明鴻	US 12,260,891 B2	2025-03-25	晶圓製造(Foundry / 先進元件製程), 鐵電材料與新型 FET 結構的晶圓製造技術

項次	專利名稱	國別	發明人	證書號	取證日	技術領域
9	高電子遷移率電晶體及其製備方法	日本	張翼,林岳欽,楊賀宇,曾皓	特許 7755332	2025-10-07	晶圓製造(Foundry / 第三代半導體)・應用於高頻 RF、5G、雷達、以及高效率功率元件
		韓國		10-2846280	2025-08-11	
10	高頻高效率脈衝雷射發射器系統	台灣	成維華,張翼,郭浩中,唐立權,洪瑜亨,杜長慶,柳景耀,謝岳璵,余政謙	I871811	2025-02-01	IC 設計・ToF、LiDAR、光通訊、3D 感測與高頻雷射發射系統
11	P型氮化鎵半導體裝置及其製作方法	台灣	吳添立,陳泓君,林子恒	I894905	2025-08-21	晶圓製造(Foundry / 第三代半導體)・應用於 P-GaN 功率元件、E-mode HEMT、車用電源、工控與快充等高效率功率半導體領域
12	雙閘極高電子遷移率電晶體	台灣	許恒通,邱炳勳	I870058	2025-01-11	晶圓製造(Foundry / 第三代半導體)・第三代半導體晶圓製造・並應用於 RF 通訊、雷達及高效率功率電子元件
13	功率元件之動態導通電阻與臨界電壓不穩定性之量測電路及其操作方法	台灣	吳添立,盧斯坦	I883950	2025-05-11	半導體設備・應用於 GaN/SiC 功率元件的動態 R_{on} 與 V_{th} 不穩定性量測・並支援電動車、工控與高效率電源領域
14	顯示器之單位畫素的生成方法	台灣	田仲豪,李杰恩,蔡沛珈,李宜家,林坤園	I880829	2025-04-11	IC 設計・應用於 LCD、OLED、MicroLED、AR/VR 等顯示裝置的子畫素配置與畫素設計
15	多相位雙邊緣數位脈衝寬度調變裝置	台灣	廖育德,楊映渝,林奕廷	I904879	2025-11-11	IC 設計・應用於 PMIC、馬達驅動、LED 驅動與高速時序控制電路
16	可編程調整像素解析度的電容感測陣列晶片及其取樣裝置與其控制系統	台灣	李鎮宜,賴林鴻,林文約	I885910	2025-06-01	IC 設計・電容感測 IC 設計技術・應用於觸控、指紋辨識、IoT 感測與人機介面裝置・可動態調整解析度以提升感測效果與能源效率
17	可編程的介電泳半導體晶片及其封裝結構與控制系統	台灣	李鎮宜,林文約,賴林鴻	I891430	2025-07-21	IC 設計・為可編程介電泳微電極的 IC 設計技術・主要應用於生醫感測、微流體晶片、單細胞操作與 Lab-on-Chip 系統
18	記憶體內運算(CIM)裝置及其縮放係數的訓練方法	台灣	張添烜,林民翰	I884084	2025-05-11	IC 設計・屬於 AI 加速器與 Edge AI 的 IC 設計領域・應用於 AI 模型量化、模型縮放與高效率 AI 推論晶片

項次	專利名稱	國別	發明人	證書號	取證日	技術領域
19	適用於反平方根運算和倒數運算之間切換的電路架構	台灣	黃俊達,吳絜恩,胡庭偉	I882937	2025-05-01	IC 設計，屬於高速數學運算邏輯的 IC 設計技術，應用於 AI 加速器、DSP、GPU、通訊晶片與各類需快速倒數/反平方根運算的系統
20	METHOD FOR MANUFACTURING A CONDUCTIVE BRIDGING MEMORY DEVICE	美國	劉柏村,許智傑,甘鎧誌	US 12,290,010 B2	2025-04-29	晶圓製造(Foundry / Memory Process)，應用於低功耗嵌入式記憶體、AI 記憶體運算、IoT 裝置與下一代非揮發性記憶體
21	立體式源極接觸結構	台灣	崔秉鉞,王睿誠,薛立甜,蕭瑞澤	I885289	2025-06-01	晶圓製造(Foundry / Power Device Process)，應用於高效率電源、車用電子、快充、工控馬達驅動等各式功率半導體元件。製程差異：lateral etch
22	立體式源極接觸結構	台灣	崔秉鉞,王睿誠,薛立甜,蕭瑞澤	I885290	2025-06-01	晶圓製造(Foundry / Power Device Process)，應用於高效率電源、車用電子、快充、工控馬達驅動等各式功率半導體元件。製程差異：spacers
23	PROCESS METHOD FOR FABRICATING A THREE-DIMENSIONAL SOURCE CONTACT STRUCTURE	美國	崔秉鉞,王睿誠,薛立甜,蕭瑞澤	US 12,408,372 B2	2025-09-02	晶圓製造(Foundry / Power Device Process)，應用於高效率電源、車用電子、快充、工控馬達驅動等各式功率半導體元件。製程差異：lateral etch 或 spacer 法均可
24	量子裝置與其製造方法	台灣	李佩雯,王奕翔,洪柏喻	I877493	2025-03-21	晶圓製造(Foundry / 特殊元件製程)，主要應用於量子運算、量子感測及高溫運作的量子元件平台，是屬於 next-generation、beyond-CMOS 的半導體技術
25	THIN-FILM TRANSISTOR DEVICE	美國	劉柏村,李振豪,蔣宗哲,郭柏儀	US 12,432,983 B2	2025-09-30	顯示面板製造(TFT / OLED / LCD)，主要用於高解析度 AMOLED/LCD 顯示器及下一代柔性、穿戴式與整合式顯示器背板
26	GALLIUM NITRIDE TRANSISTOR	美國	張翼,吳瑞笙	US 12,369,375 B2	2025-07-22	晶圓製造(Foundry / 第三代半導體)，屬於 GaN 電晶體結構的晶圓製造技術，應用於高效率功率半導體、RF 通訊與快充/伺服器電源

聯繫窗口

國立陽明交通大學 智權中心

聯絡人：連雅苹 智權推廣專員

電話：02-28267000 #66342

Email：irislien@nycu.edu.tw